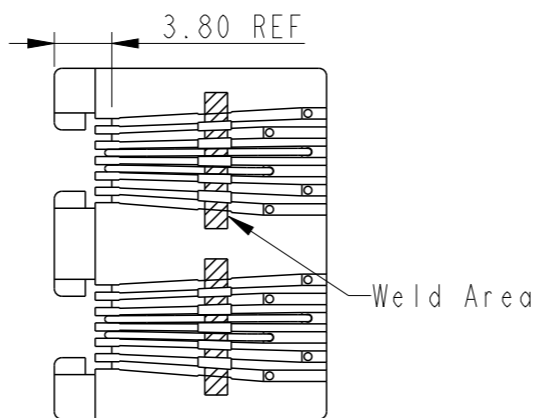
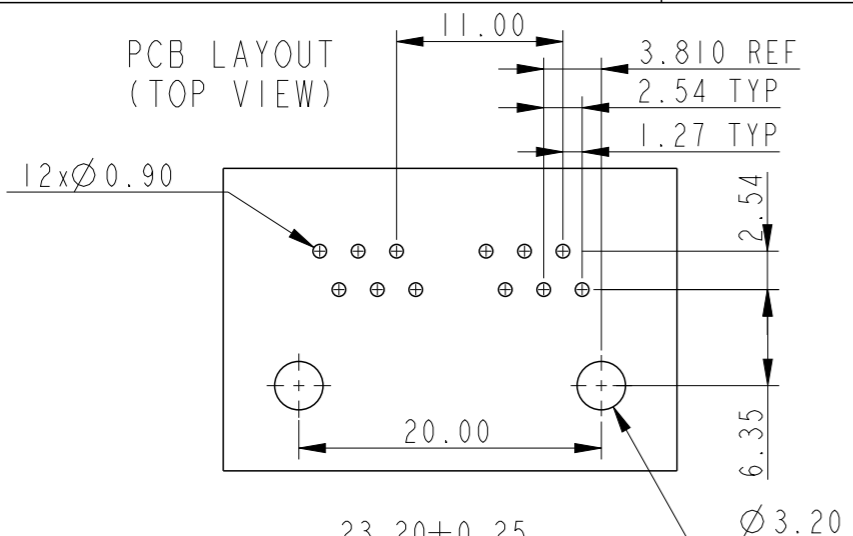


PCB LAYOUT  
(TOP VIEW)



NOTES:

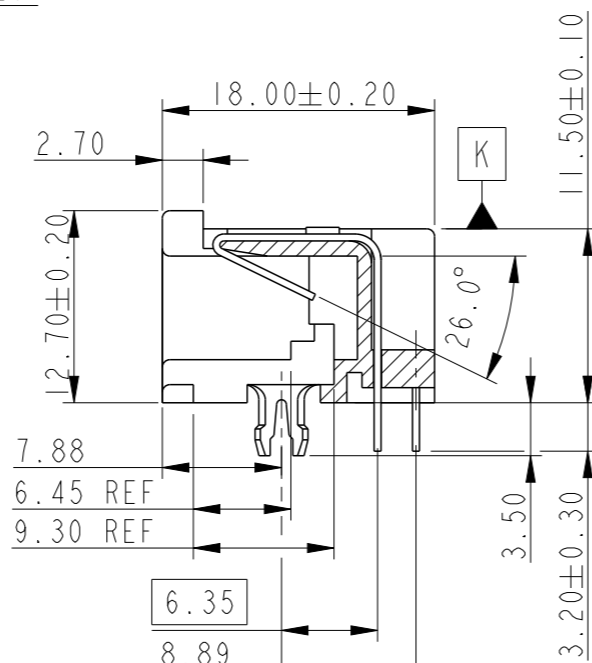
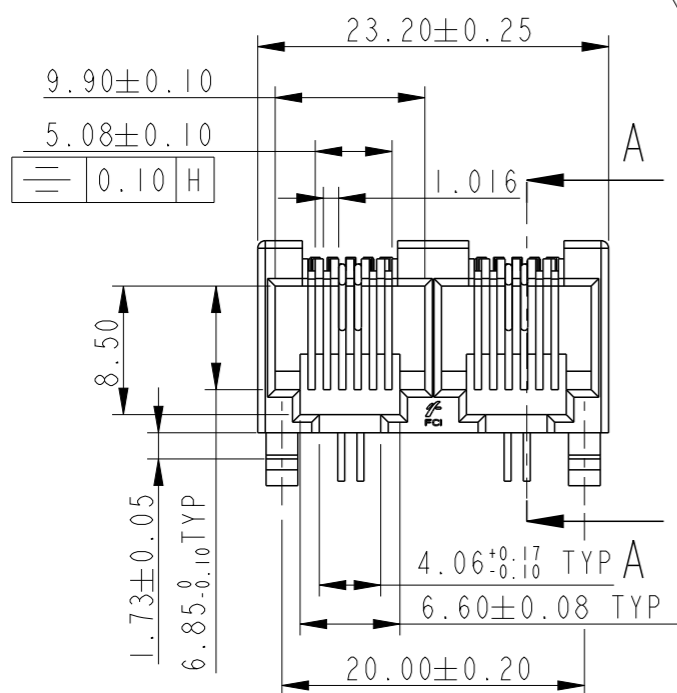
1. PLATING DETAILS:  
ACTIVE ZONE : GOLD OVER NICKEL (REF. ORDERING INFORMATION)  
TERMINATION ZONE: SnPb OVER NICKEL FOR LEADED VERSION  
: MATTE TIN OVER NICKEL FOR LEADFREE VERSION.
2. CONTACT WIRE SHOULD NOT TO BE EXPOSED IN THE WELD AREA.  
WELD FLASH NOT TO EXCEED 0.30 ABOVE DATUM  $\square$  AND WELD STRENGTH TO BE CHECKED FOR WITHSTANDING 500g.FORCE MIN.ON INDIVIDUAL CONTACTS
3. ALL WIRES MUST BE CONTAINED IN THE SHELF.

PART NO. 10053565-X12 XXX LF

LEAD FREE

CONTACTS LOADED

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 6 - 0.76 Au SELECTIVE MIN.  | BLANK- CTS. LOADED IN ALL POS.           |
| 7 - Au FLASH SELECTIVE MIN. | 001 - CTS. LOADED IN A3,A4,B3 & B4       |
| 8 - 1.27 Au SELECTIVE MIN.  | 002 - CTS. LOADED IN A2 TO A5 & B2 TO B5 |
| 9 - 0.38 Au SELECTIVE MIN.  |  |



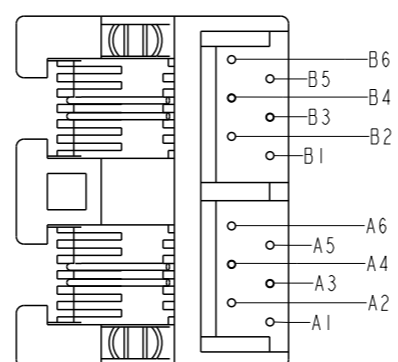
1. LF PRODUCTS MEETS EUROPIEN UNION DIRECTIVES&OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.

2. THE HOUSING WILL WITHSTAND 260°PEAK TEMPERATURE FOR 5 SEC IN A WAVE SOLDER APPLICATION WITH A 1.6mm MIN THICK CIRCUIT BOARD.SLIGHT DEFORMATION OF SNAP PEGS MAY OCCUR AT 260-265°C,WHICH WILL NOT AFFECT THE FUNCTION OF THE PRODUCT.

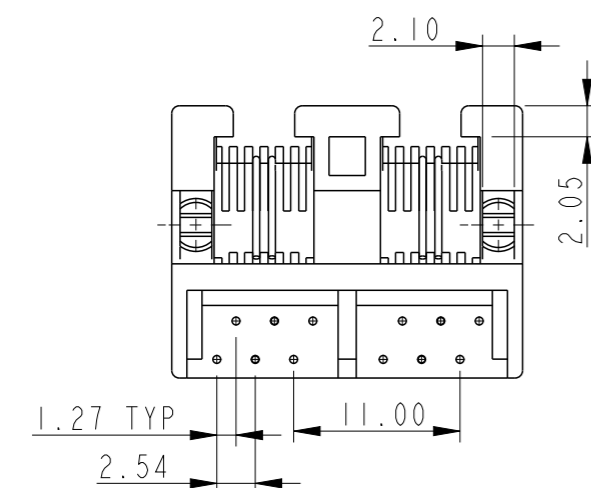
3. LEAD FREE OR ROHS DIRECTIVE LABELLING TO BE PROVIDED AS PER GS-14-920 FOR LEAD FREE VERSION.

MATERIAL

Housing : PBT 30% GF BLACK UL 94-V0  
The Housing will withstand exposure to 260-265° for 5 seconds. Use protective adhesive tape(kapton or teflon)or protective metallic device on the areas which are directly exposed to wave soldering as it is used in classical leaded wave soldering  
Contact : Ø 0.46 PHOSPHOR BRONZE ROUND WIRE



WIRE POSITION



Technical specifications

Insulation Resistance - 500 M Ohms min.  
Dielectric Strength - 1000 V rms , 60 Hz.  
Contact Resistance - 20 m Ohms to 30 m ohms. max.  
Current Rating - 2.0 amp DC  
Maximum Total Mating Force - 20 N  
Retention Force Between Plug & Jack - 22.5 N min.  
Durability - 250 mating cycles

rev	ecn no	dr	date
C	106-0105	HVN	2006-07-06
D	108-0117	NPM	2008-09-17
E	110-0137	NPM	2010-06-23
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

www.fciconnect.com		surface	tolerance std	projection	mm
		✓	-	$\oplus$ $\ominus$	↔
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
Dr	HIRAN V N	2005-03-09	ANGULAR	0.X	±0.2
Eng	HIRAN V N	2005-03-09	LINEAR	0.XX	±0.13
Chr	NEBU PM	2010-06-23	0° ±2°	0.XXX	±0.08
Appr	HIRAN V N	2010-06-23	Product family	MODJACKS	Spec ref GS-12-083
FCI		6/6 GANG JACK		dwg no	10053565
		2 PORT MODJACK		Rev.	E
		catalog no		sheet 1 of 1	

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9